



FTDI Chip stellt Entwicklungsmodule für hochauflösende EVE-Bausteine vor

30. September 2015 - FTDI Chip erweitert das Angebot an Entwicklungstools für seine EVE-Plattform (Embedded Video Engine) für fortschrittliche Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI; Human Machine Interface). Die Erweiterung bezieht sich auf die FT810-Serie hochauflösender EVE-Bausteine, die nun in Serie gefertigt werden. Dafür stehen jetzt die kompakten Entwicklungsmodule der VM810C50-Reihe zur Verfügung. Sie erweitern die Funktionalität der VM800C-Reihe, die für die FT800 ICs ausgelegt ist, und sorgen neben schneller aufbereiteten Bildern mit höherer Auflösung auch für schnellere Datenübertragungsraten.

Das VM810C50A-D bietet ein 5-Zoll-TFT-Display mit WVGA-Auflösung (800 x 480 Pixel) und resistivem Touchscreen. Beim VM810C50A-N ist das Display nicht mit enthalten. Hier lässt sich über eine 40-Pin-FFC-Schnittstelle ein geeignetes 4,3-/5,0-Zoll-LCD (mit SVGA-, WVGA-, VGA-, WQVGA- oder QVGA-Auflösung und einem 4-Draht resistiven Touchscreen) anschließen. Somit lässt sich das am besten geeignete Display auswählen.

Beide dieser kreditkartengroßen Module agieren über ihre SPI-Schnittstellen als SPI Slaves am spezifizierten System-Mikrocontroller. Sie verfügen über einen Mikro-Lautsprecher, Audio-Verstärker, 3-stufigen Audio-Filter, optionalen

Audio-Ausgang und eine LCD-Hintergrundbeleuchtungssteuerung. Die Versorgung der Module erfolgt entweder über die 2-mm-Buchse (Netzteil), den USB Micro-B Port oder die SPI-Schnittstelle. Letztere unterstützt 5V-tolerante Puffer, wenn eine 5V-SPI-Versorgung zum Einsatz kommt.

Die FT810 EVE-ICs von FTDI Chip vereinen Touch-, Display- und Audio-Funktionen auf einem einzigen Baustein und sorgen für einen innovativen Ansatz bei der HMI-Implementierung, bei dem FTDI Pionierarbeit leistete. Dabei werden Vorlagen, Überlagerungen, Schriften und Töne als Objekte behandelt. Mit diesem objektorientierten Ansatz lassen sich Grafiken zeilenweise mit 1/16 Pixel-Auflösung anstatt pixelweise aufbauen (rendern). Damit vereinfacht sich die Umsetzung, was die Kosten senkt, Platz auf der Leiterplatte einspart und die Systemkomplexität verringert. Der FT810 und andere Bausteine der FT81x-Serie können mit Displays mit bis zu 800 x 600 Pixel Auflösung betrieben werden. Sie bieten eine 18- oder 24-Bit-RGB-Schnittstelle und 1 Mbyte RAM zur Speicherung von Grafikdaten. Eine integrierte JPEG-Dekomprimierungs-Engine sorgt für eine bessere Nutzung der Grafikdaten und ermöglicht eine effektivere HMI-Umsetzung. Die Bausteine unterstützen mehrere Farbpaletten wie 16 und 32 Bit mit Transparenz. Die SPI-Schnittstelle unterstützt einen Betrieb mit 30 MHz Taktfrequenz.

Weitere Informationen über die VM810C50-Module unter:

www.ftdichip.com/ft81x

Über FTDI Chip

FTDI Chip bietet innovative Halbleiterlösungen, mit denen sich die Interaktion mit heutiger Technologie vereinfacht. Mit seinem Konzept „Design Made Easy“ bietet das Unternehmen hochentwickelte, funktionsreiche, robuste und einfach anwendbare Plattformen. Damit lassen sich Elektronikdesigns mit höherer Leistungsfähigkeit, weniger Peripherie, geringerer Stromaufnahme und kleinerem Platzbedarf auf der Leiterplatte entwickeln.

FTDI Chips etabliertes und kontinuierlich erweitertes USB-Angebot (Universal Serial Bus) umfasst die Marken R-Chip, X-Chip, Vinculum und die H-Serie. Neben Host- und Bridge-ICs zählen dazu auch hochintegrierte Systemlösungen mit integriertem Mikrocontroller (MCU). Die Embedded Video Engine (EVE) Grafikcontroller vereinen Display-, Audio- und Touch-Funktionen auf einem Chip. Dieser einzigartige Ansatz verringert die Entwicklungsdauer und die Materialkosten neuer Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI, Human Machine Interface). FTDI Chip bietet auch differenzierte, auf Geschwindigkeit optimierte MCUs mit erweiterten Datenanbindungsmöglichkeiten. Diese AOCs (Application Oriented Controller) richten sich an Anwendungen, die höhere Rechenleistung und einen effizienteren Betrieb erfordern.

FTDI Chip ist ein Fabless-Halbleiterhersteller, der mit weltweit führenden Foundries zusammenarbeitet. Der Sitz des Unternehmens befindet sich im schottischen Glasgow; Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen finden sich in Glasgow, Singapur und Taipeh (Taiwan). Vertriebsniederlassungen und technischer Support ist zudem in Glasgow, Taipeh, Portland (Oregon, USA) und Schanghai (China) ansässig.

Weitere Informationen unter: <http://www.ftdichip.com>

For further information and reader enquiries:

Steven van der Wolf - FTDI Chip

Unit 1, 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow, G41 1HH, UK

Tel: +44 (0) 141 429 2777 Fax: +44 (0) 141 429 2758

E-mail: marketing@ftdichip.com

Issued by:

Mike Green - Pinnacle Marketing Communications Ltd

Tel: +44 (0)20 84296543

E-mail: m.green@pinnaclemarcom.com

Web: www.pinnacle-marketing.com

September 2015 Ref: FTDIPR62/GER